

2011年3月期 中間決算会社説明会

2010年11月

TOWA株式会社

第2四半期業績

(百万円)

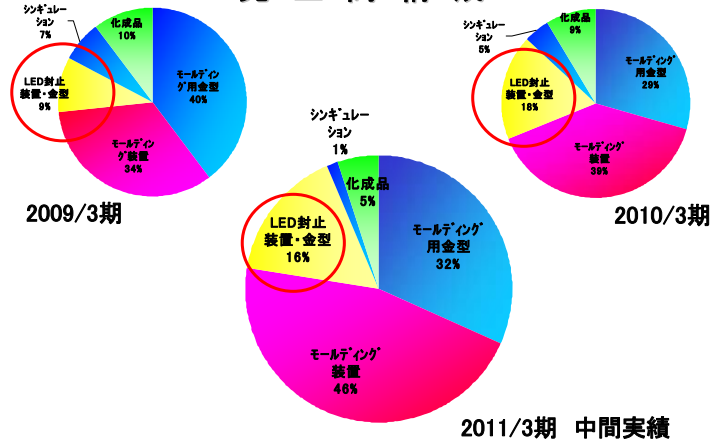
	前年同期	期初予想	上期実績	前年比
売上高	5,831	10,000	12,544	+6,713
営業利益	▲867	500	2,691	+3,558
経常利益	▲1,037	450	2,625	+3,662
当期純利益	▲979	400	2,515	+3,494

通期業績予想(修正)

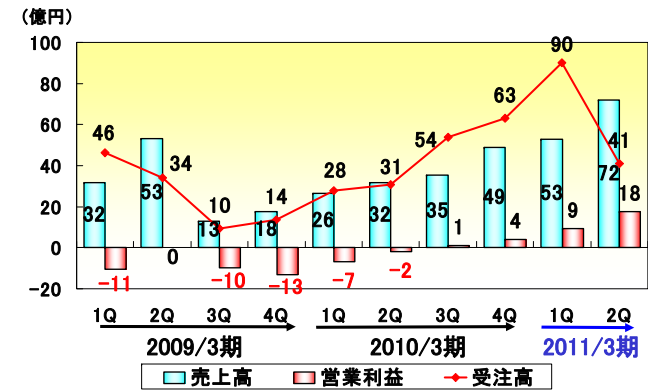
(百万円)

	前期	期初予想	11/11修正予想	前期比
売上高	14,274	20,000	22,500	+8,226
営業利益	▲338	1,000	3,600	+3,938
経常利益	▲345	900	3,500	+3,845
当期純利益	▲330	800	3,400	+3,730

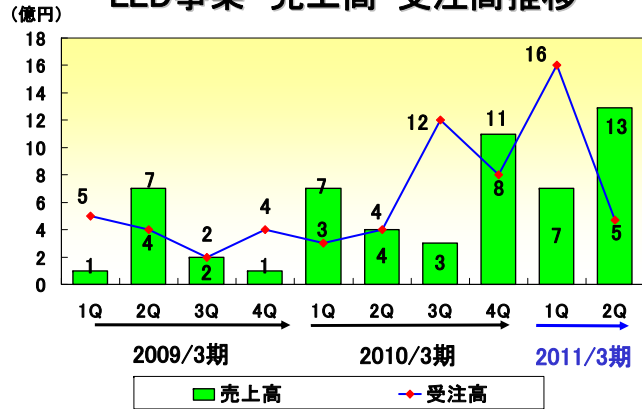
売上高構成



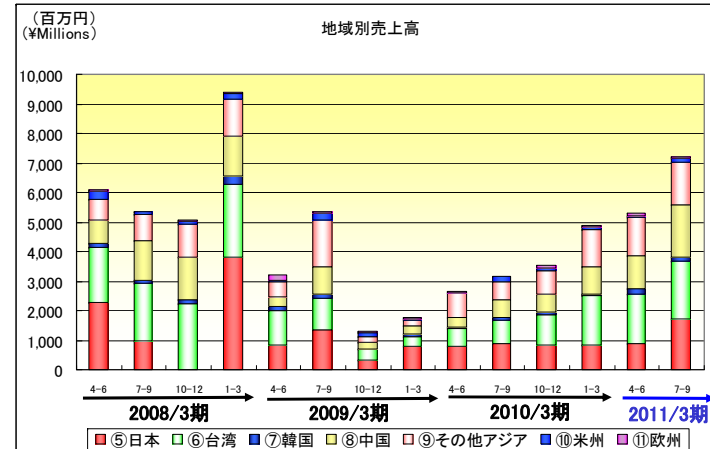
受注高・売上高・営業利益推移



LED事業 売上高・受注高推移



地域別売上高



地域別動向

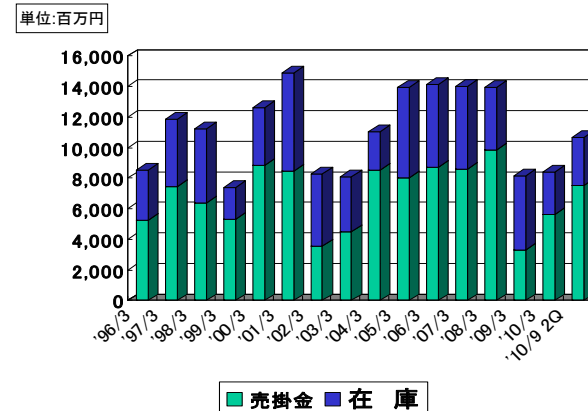
台湾

- 9月以降は調整色が鮮明
- IC系製品の減産が目立つ
- スマートフォン(ex. iPhone)の好景気にノートPCはおされ気味
- フラッシュ系は引き続き高稼働率を維持している模様
- 短期的にはDRAMが不透明

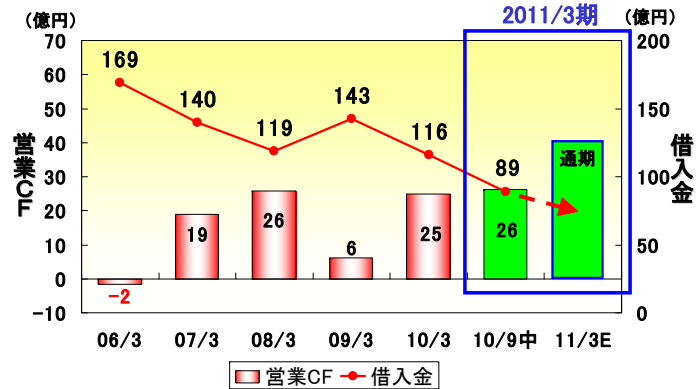
中国

- IC系は減産(ノートPCの減速が影響)
- 携帯・家電・民生品等のディスクリート系(SOT,TO)は高い稼働率を維持
- 投資は当面、ディスクリート系に集中する傾向
- ローカル企業は政府援助で事業拡大を図る計画(3年で生産高倍増・・・)

売掛金・棚卸資産推移



営業キャッシュフロー・借入金推移



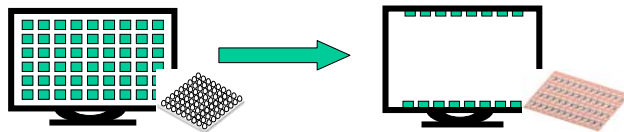
業界動向

- 1Q 好調 !!
 - ・不況期の反動 + 携帯・3DTVなどの需要も好調
 - ・売上・受注ともに高水準
 - ・中国が世界経済を牽引
- 2Q 電子機器(PCなど)の消費者需要が落ち込む
 - ・半導体のサプライチェーン全体で在庫が増加傾向
 - ・売上は好調(1Q受注分の出荷)ながら、受注は鈍化
- 円高相場が急激に進行
 - ・80円台に突入、70円台も・・・

LED事業

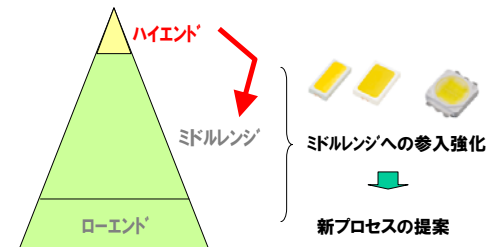
1) バックライト用途

- ① 海外製の低価格LED-TVのラインナップが出揃う
→国内メーカーは海外のTVシェアを奪われる状況
- ② 韓国・台湾・中国産の低価格LED-PKGが出回り始めた
→国内メーカーは外部調達へのシフトを検討(設備投資に慎重な姿勢へ)
- ③ LED-TVの普及方式 「直下型」 < 「エッジライト型」
- ④ 国内メーカーは低価格TVの開発が急務
→エッジライト向けのリフレクター製品の動向が活況



2) 照明用途

- ① ハイエンドの照明用に受注はまずまず
- ② LEDを光源とする照明市場はミドル、ローエンドへ確実に展開している
→LEDメーカーはさらにコストダウンが必要
- ③ 切断工程の提案も含めて各社が技術開発



上期のサマリー

- 市況の立ち上がり時にトップシェアの強みを十分に発揮し、増産対応、海外直出荷体制等により、好機を逃さず最大限の利益を確保できた。
- キャッシュフロー重視の経営は超繁忙期にも徹底し、財務体質の改善は着実に進行している。

下期の半導体市場は・・・

- ★前半＝調整局面が継続 後半＝緩やかな上昇基調へ
- ★タブレット端末等の新しい電子機器が半導体需要を牽引する
- ★中国市場では相応の投資が継続される(ハイエンドまでは行かない)
- ★台湾のアッセンブリーハウスは比較的積極的な投資姿勢
- ★LED市場は順調に拡大するが、技術的な“模索”が継続
- ★中国ローカル、韓国勢のLEDメーカーが台頭

下期業績計画

(百万円)

	上期実績	下期計画
売上高	12,544	10,000
営業利益	2,691	1,000
経常利益	2,625	950
当期純利益	2,515	900

当社の下期見込み・・・

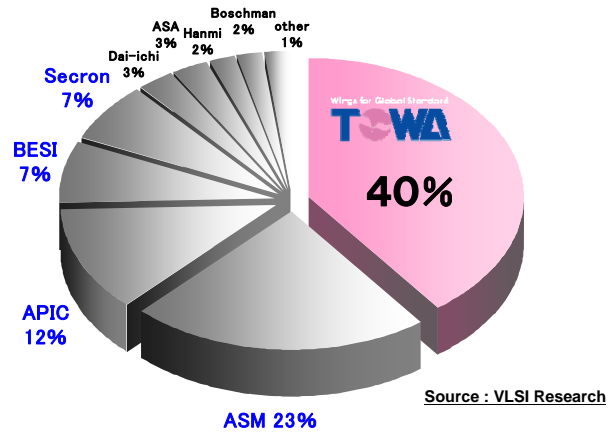
- 売上高
 - ・受注残(65億円)+3Q受注 ⇒ 今期売上高へ計上
- 損益
 - ・競合先が為替メリットを活かして価格競争を挑んでくる
 - ローエンド用の製品群では利益率が悪化する
 - コンプレッションは優位性を維持
- 受注高
 - ・上期比の減速はやむを得ない
 - ・4Qから回復し、緩やかながら再び成長局面に移行する
 - ・LEDは引き続き技術力の競争、あらたなソリューションを提供する

十分可能な水準

少なからず為替の影響は出る

クラッシュの様な市況におちいることはない

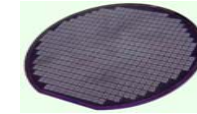
2009年度 世界オートモールド装置市場シェア



下期の取組み

(1) 製品開発にこだわる

- ・大判化、WLPへの対応
- ・LED製造プロセスに新たなソリューションを提供



(2) 装置のコストダウン

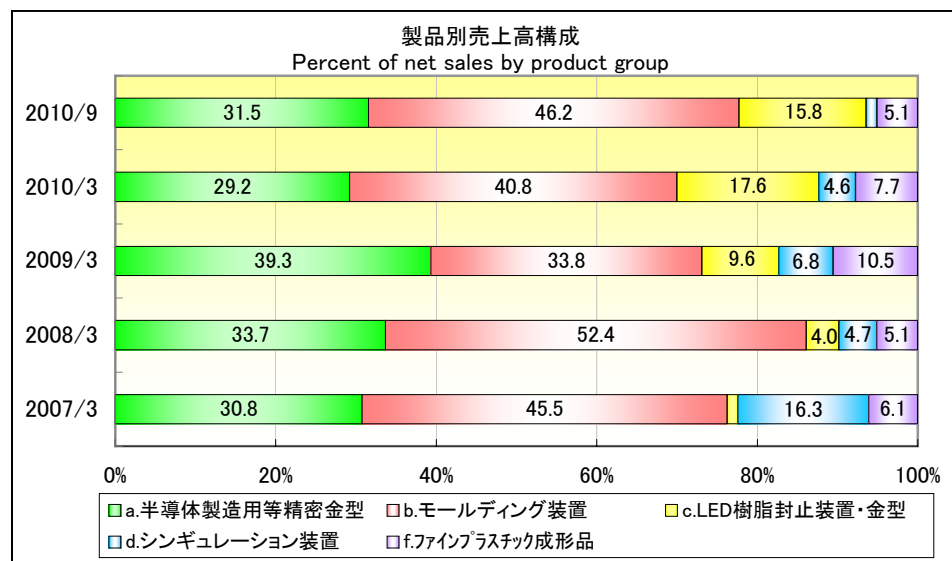
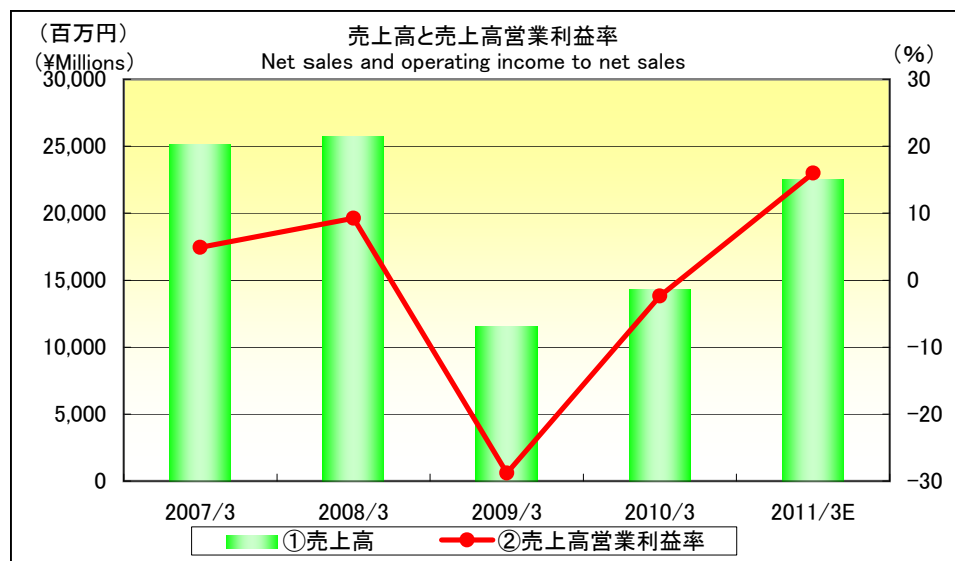
- ・トランスファーの価格競争に対応
- ・コンプレッションの市場浸透に先行してコストダウンにチャレンジ
- ・生産拠点の見直し、現地購買の推進

(3) 販売チャネルの見直し

- ・販売事業会社、代理店等販売チャネルのベストマッチを再検討



I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)

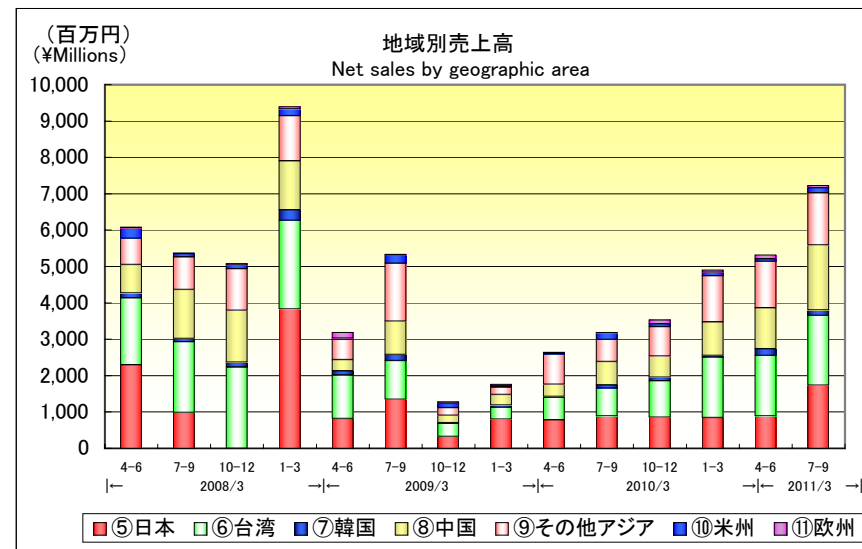
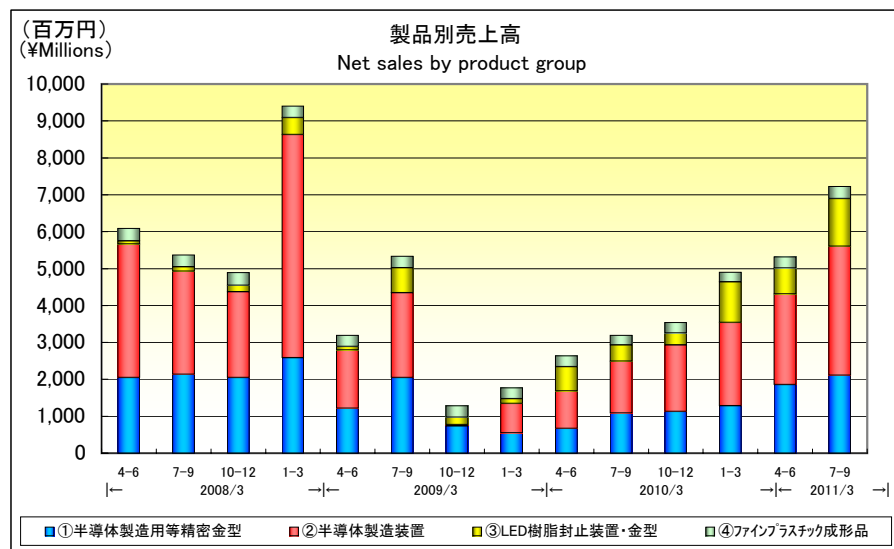


決算期		2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3E
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	25,159	25,753	11,577	14,274	22,500
営業利益	Operating income	1,224	2,381	-3,337	-338	3,600
経常利益	Ordinary income	1,289	2,125	-3,677	-345	3,500
当期純利益	Net income	1,038	2,118	-4,163	-330	3,400
総資産	Total assets	34,925	34,360	27,949	26,738	-
純資産	Net assets	14,941	16,394	11,089	11,091	-
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	41.59	84.70	-166.45	-13.19	135.93
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	7.4	13.5	-30.3	-3.0	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	3.6	6.1	-11.8	-1.3	-
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	4.9	9.2	-28.8	-2.4	16.0
自己資本比率	Equity ratio	42.8	47.7	39.7	41.5	-

(単位: 百万円/¥Millions)

	2009/9	2010/9
	5,831	12,544
	-867	2,691
	-1,037	2,625
	-979	2,515
	25,122	28,378
	10,200	13,291
	-39.15	100.55
	-9.2	20.6
	-3.9	9.5
	-14.9	21.5
	40.6	46.8

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



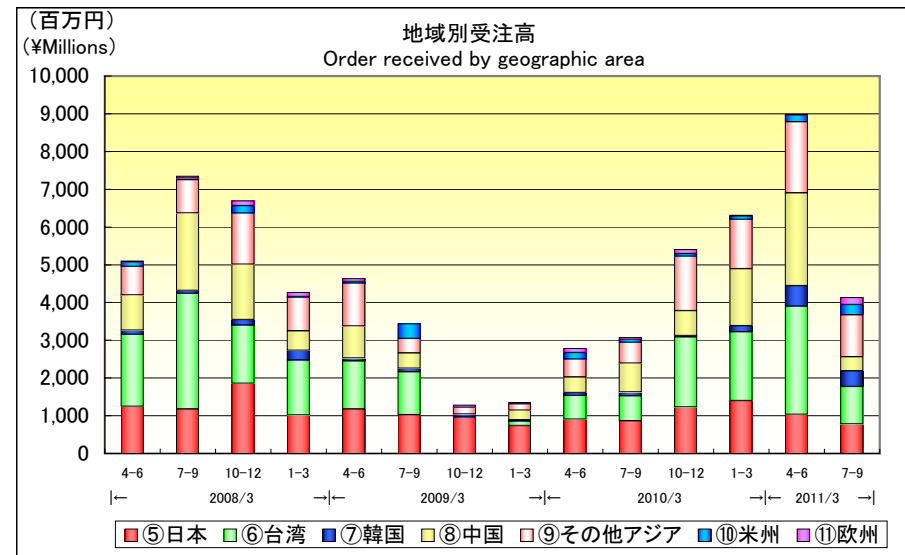
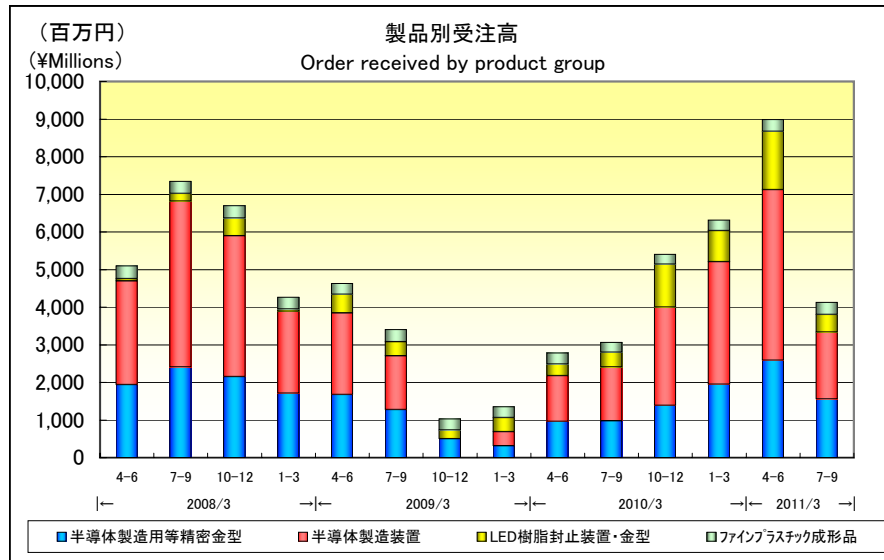
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	12,544
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	2,045	2,134	2,049	2,587	8,815	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	3,956
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	3,615	2,794	2,323	6,045	14,778	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484	2,462	3,499	5,962
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	93	122	176	454	846	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	1,988
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	336	319	345	312	1,313	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102	304	332	636
月平均	2,030	1,789	1,631	3,132	2,146	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	2,091

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	12,544
日本 ⑤Japan	2,300	983	-186	3,826	6,924	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379	889	1,735	2,625
アジア太平洋 Asia pacific	3,477	4,283	4,941	5,318	18,020	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305	4,253	5,290	9,544
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,841	1,944	2,237	2,443	8,465	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	3,582
(内 韓国) ⑦Korea	131	89	130	287	639	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253	187	152	339
(内 中国) ⑧China	781	1,350	1,425	1,351	4,908	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	2,912
(内 その他アジア) ⑨Other asia	722	899	1,148	1,235	4,006	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	2,711
米州 ⑩America	284	83	97	188	654	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382	70	145	215
欧州 ⑪Europe	28	19	41	65	154	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207	103	55	159

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



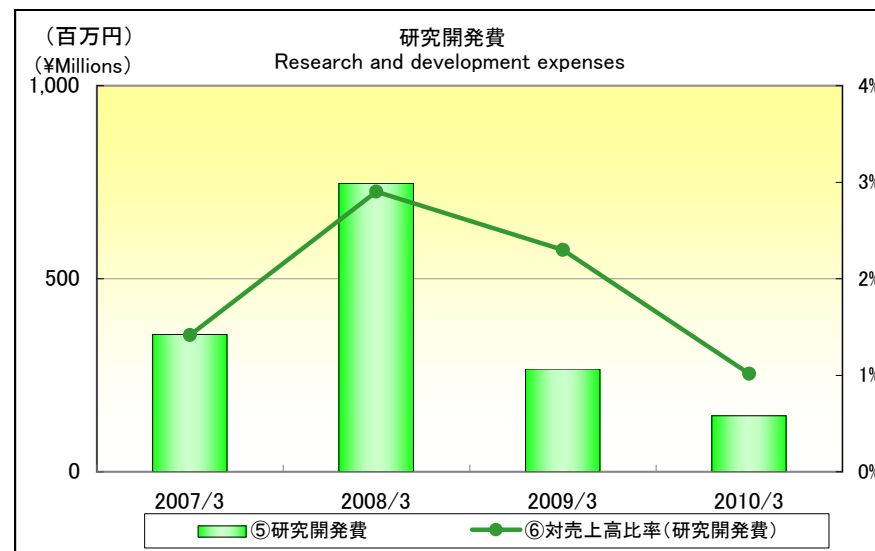
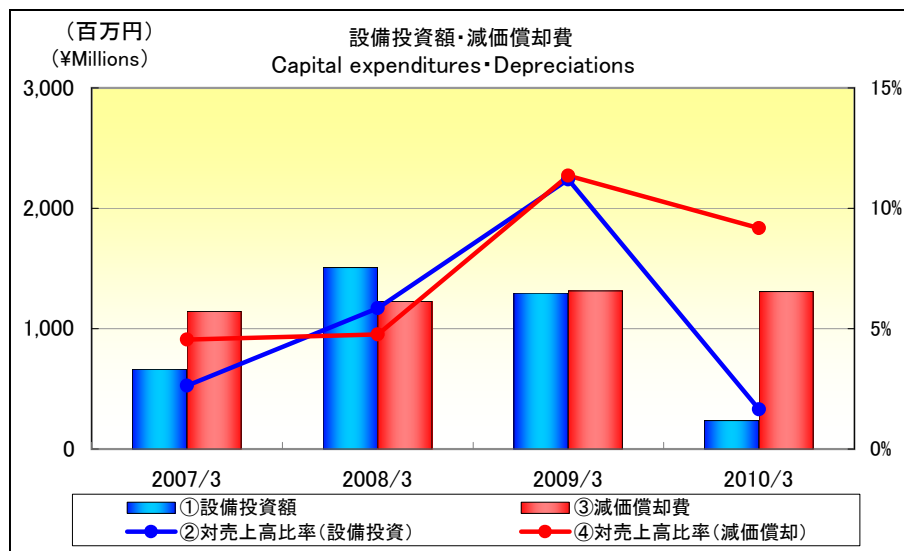
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	13,121
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,937	2,411	2,149	1,708	8,207	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	4,141
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	2,760	4,404	3,753	2,178	13,096	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524	4,539	1,784	6,323
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	57	210	466	62	797	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	2,011
ファインプラスチック成形品 ④ Engineering plastic molded products	342	318	328	318	1,308	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110	316	327	644
月平均	1,699	2,448	2,232	1,422	1,951	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	2,187

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	13,121
日本 ⑤ Japan	1,249	1,176	1,854	1,015	5,295	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	1,819
アジア太平洋 Asia pacific	3,706	6,078	4,515	3,125	17,425	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471	7,753	2,893	10,646
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,909	3,063	1,548	1,459	7,981	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	3,856
(内 韓国) ⑦ Korea	108	81	143	253	586	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364	546	415	962
(内 中国) ⑧ China	935	2,054	1,471	525	4,986	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	2,832
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	753	878	1,351	887	3,871	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	2,995
米州 ⑩ America	113	41	202	17	375	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417	168	268	437
欧州 ⑪ Europe	28	50	124	110	313	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287	29	188	218

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)		(Consolidated)				
決算期		2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2010/9
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	1,894	2,587	606	2,494	2,604
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	252	-1,083	-1,490	-290	-238
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-2,203	-1,947	1,972	-2,733	-2,564
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at	3,542	3,351	4,399	3,836	3,551
設備投資額	①Capital expenditures	663	1,508	1,296	236	285
対売上比率	②Ratio of sales	2.64	5.86	11.19	1.65	2.27
減価償却費	③Depreciations	1,144	1,227	1,315	1,309	577
対売上比率	④Ratio of sales	4.55	4.76	11.36	9.17	4.60
研究開発費	⑤Research and development expenses	356	747	266	145	206
対売上比率	⑥Ratio of sales	1.42	2.90	2.30	1.02	1.64

(単位:百万円/¥Millions)

	2009/9
	738
	-318
	-1,709
	3,071
	150
	2.57
	639
	10.96
	70
	1.20

この資料についてのお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料おける予想は、現在入手可能な情報から得られた情報に基づいており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
実際の業績は、様々な要因により、これらの予想とは異なることがあります。